

天津中环半导体股份有限公司 关于为子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、投资基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”），负责实施公司集成电路用大直径硅片项目。为满足项目资金需求，保证项目顺利实施，各股东方拟同比例向中环领先增资 27 亿元，其中公司增资 8.1 亿元、公司全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）增资 8.1 亿元、无锡市人民政府下属公司锡产投资（香港）有限公司（以下简称“锡产香港”）增资 8.1 亿元、浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）增资 2.7 亿元。

增资完成后，中环领先注册资本将由 50 亿元变更为 77 亿元，其中公司持股比例 30%、中环香港持股比例 30%、锡产香港持股比例 30%、晶盛机电持股比例 10%保持不变。

2、董事会审议表决情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意向中环领先增资事项。

3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议决策事项。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

中环领先基本情况如下：

- 1、公司名称：中环领先半导体材料有限公司
- 2、住所：宜兴经济技术开发区东氦大道
- 3、法定代表人：沈浩平

4、注册资本：500,000 万元人民币

5、经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。

6、最近一年一期的主要财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 275,997.99 万元，总负债 22,133.74 万元，净资产 253,864.24 万元；2018 年度实现营业收入 0.38 万元，净利润 3,864.24 万元（经审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，资产总额为 577,174.12 万元，负债总额为 114,221.89 万元，净资产为 462,952.23 万元；2019 年 1-6 月实现营业收入为 32,212.04 万元，净利润 4,305.19 万元（未经审计）。

三、定价依据及增资方式

本次各股东方同比例向中环领先增资，其中公司以现金方式增资 8.1 亿元、中环香港以现汇方式增资 8.1 亿元、锡产香港以现汇方式增资 8.1 亿元、晶盛机电以现金方式增资 2.7 亿元。

增资完成后，中环领先注册资本将由 50 亿元变更为 77 亿元，其中公司持股比例 30%、中环香港持股比例 30%、锡产香港持股比例 30%、晶盛机电持股比例 10%保持不变。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为中环领先增资，是根据公司半导体材料产业发展的需要，为集成电路用大直径硅片项目顺利实施提供资金保障，有利于保证半导体整体战略的稳步推进，增强公司的综合实力。

2、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2019 年 9 月 3 日